

长鑫科技：以存储科技赋能信息社会 成为技术领先与商业成功的DRAM企业——长鑫科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会精彩回放

出席嘉宾

长鑫科技集团股份有限公司董事长
长鑫科技集团股份有限公司副总裁、董事会秘书
长鑫科技集团股份有限公司高级副总裁、财务负责人

中国国际金融股份有限公司
中国国际金融股份有限公司保荐代表人
中信建投证券股份有限公司保荐代表人
中信建投证券股份有限公司保荐代表人

朱一明先生
袁 园女士
黄丹阳女士

吴 迪先生
魏先勇先生
董军峰先生
廖小龙先生

长鑫科技集团股份有限公司董事长朱一明先生致开场词



尊敬的各位投资者朋友和关注长鑫科技的各位网友：

大家好！非常高兴与大家相聚于此，我谨代表公司董事会和管理团队，向长期信任和支持长鑫科技的广大投资者、合作伙伴、客户朋友，以及一路拼搏奋斗的全体员工，致以最诚挚的感谢！正是因为大家的支持与陪伴，我们才能一步步走到今天。

长鑫科技坚定走自主创新之路。自2019年成功推出首颗自主设计的8Gb DDR4芯片，实现中国DRAM(即动态随机存取存储器)产业“从0到1”的历史性突破

以来，公司坚持高强度研发投入，采取跳代研发策略，快速完成从第一代到第四代工艺平台的量产，实现DDR5、LPDDR5/5X等产品的覆盖和迭代。每一次技术突破的背后，都凝聚着无数长鑫人的坚守与付出，也见证着中国存储产业不断向前迈进的坚定步伐。

登陆资本市场，对长鑫科技而言既是新的起点，更意味着新的责任。我们希望通过本次募集资金投资项目，进一步提升技术研发能力和产业化水平，增强对市场需求的保障能力；同时，发挥龙头企业的带动作用，促进产业链协同发展，为我国集成电路产业生态建设贡献更大力量。

面向未来，我们将始终坚持自主创新的发展道路。我们将继续保持对技术的敬畏、对创新的投入和对产业的热爱，持续提升核心竞争力，努力建设具有全球影响力的半导体存储企业。我们也期待与广大投资者携手同行，共同分享中国集成电路产业发展的时代机遇，以长期稳健的发展回报社会各界的信任与支持。

最后，再次感谢各位投资者朋友的关注与参与。谢谢大家！

中国国际金融股份有限公司吴迪先生致辞



尊敬的各位投资者、各位线上朋友：

大家好！欢迎大家参加长鑫科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会。在此，我谨代表中国国际金融股份有限公司，对所有参与今天网上交流的嘉宾和投资者朋友表示热烈的欢迎，衷心感谢大家对长鑫科技本次发行、对国内自主存储产业发展的高度关注与鼎力支持。

长鑫科技自2016年创立以来，始终专

注于DRAM产品的研发、设计、生产及销售，快速完成了从第一代到第四代工艺技术的量产，形成DDR系列、LPDDR系列等多元化产品布局，能够有效满足服务器、移动设备、个人电脑、智能汽车等市场需求，同时，积极把握行业发展趋势，持续进行技术迭代和产品升级。

作为保荐机构，我们有幸全程参与长鑫科技从上市准备到本次发行的全过程，也得以近距离见证长鑫科技从技术突围到规模化量产的跨越式成长，更亲历中国DRAM产业实现“从0到1”的历史性突破。这份长期同行，既是中金公司服务国家科技自立自强战略的使命践行，也是资本市场助力国产科技龙头突围的生动实践。

希望通过今天的网上交流活动，我们能够帮助大家更加全面、深入、客观地了解长鑫科技，欢迎大家通过网上路演平台踊跃提问。

最后，衷心预祝长鑫科技本次网上投资者交流会圆满成功！谢谢大家！

中信建投证券股份有限公司保荐代表人董军峰先生致辞



尊敬的各位投资者朋友、各位网友：

大家好！欢迎大家参加长鑫科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演推介会。在此，我谨代表中信建投证券股份有限公司，向参与网上路演的各位嘉宾和投资者表示热烈欢迎和衷心感谢；并借此机会，向长期以来关心长鑫科技本次发行的各位朋友致以亲切的问候。

长鑫科技作为我国规模最大、技术最先进、布局最全的DRAM研发设计制造一体化企业，通过持续的产品技术水平提升及迭代，目前，公司的核心产品及工艺技术已达到国际先进水平，成为全球存储芯片这一集成电路最大单品市场上不可忽视的“中国力量”。

作为本次发行的保荐人和主承销商，中信建投证券有幸亲眼见证并亲身参与了长鑫科技攻坚克难、砥砺前行的发展历程。十年来，长鑫科技用实干行动和斐然成就诠释了长风破浪、欣欣向荣的发展韧劲。

上市是公司发展的新起点，中信建投证券将一如既往地履行保荐职责，陪伴企业在资本市场行稳致远，持续完善现代企业制度并推进高质量发展，加强与投资者的沟通交流，用真实、准确和专业的语言进一步讲好长鑫科技的发展故事。欢迎各位投资者通过网上路演平台畅言交流、互动探讨。

最后，衷心预祝长鑫科技本次公开发行取得圆满成功！谢谢大家！

长鑫科技集团股份有限公司董事长朱一明先生致结束语



尊敬的各位投资者和各位网友：

大家好！长鑫科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演即将步入尾声。非常感谢大家抽出宝贵时间，耐心聆听、坦诚提问，与我们一同完成这次深度沟通。从DRAM产业攻坚历程、技术与产能布局，到AI浪潮下的行业脉络与产业链协同，我们坦诚分享了长鑫科

技一路走来的实践、思考与长远规划，也认真记下了每一位投资者提出的问题与建议。这些宝贵声音，我们会逐条梳理，持续落地。

怀揣补齐短板、保障供应链安全的初心，长鑫科技选择走上一条重投入、长周期、高难度的自主研发之路。我们深知，未来的路还很长。我们将继续坚持高水平技术研发，持续迭代工艺与产品，夯实核心技术根基，加速产能布局。

最后，再次向所有关心和关注长鑫科技的朋友，致以诚挚谢意。感谢所有中介机构的全程专业陪伴，感谢一路给予信任与支持的企业伙伴。

未来，我们期待持续与各位保持畅通沟通，以透明、规范的上市公司标准做好信息披露，脚踏实地深耕集成电路产业，不负时代赋予的使命，不负每一份信任。

祝愿各位万事顺遂，期待后续继续携手，共同见证公司的稳步向前。



路鑫盛资会影

经营篇

问：公司的主营业务是什么？

朱一明：公司是我国规模最大、技术最先进、布局最全的DRAM研发设计制造一体化企业，采取“跳代研发”的策略，完成了从第一代工艺技术平台到第四代工艺技术平台的量产，以及DDR4、LPDDR4X到DDR5、LPDDR5/5X等产品覆盖和迭代升级。

问：公司的产品布局如何？

朱一明：公司于2019年9月推出自主设计生产的8Gb DDR4产品，实现了中国DRAM产业“从0到1”的突破。同时，公司把握行业发展趋势，持续进行产品迭代，现已形成DDR系列、LPDDR系列等多元化产品布局，并可提供DRAM晶圆、DRAM芯片、DRAM模组等多样化的产品方案，可以有效满足服务器、移动设备、个人电脑、智能汽车等市场需求。

问：公司有哪些大客户？

朱一明：公司顺应市场及产品需求，持续进行产品结构优化，提升行业头部客户黏性及销售增量。2023年至2025年，公司持续拓展与下游客户的深度合作，与下游服务器、手机和个人电脑等各类厂商建立了长期稳定的合作关系，成功进入阿里云、字节跳动、腾讯、联想、小米、传音、荣耀、OPPO、vivo等行业头部客户的供应链，客户基础不断扩大。

问：公司有多少项专利？

朱一明：截至2025年12月31日，公司共拥有3929项境内专利（其中发明专利3165项）以及3043项境外专利。公司凭借DRAM设计与制造领域的深厚技术积累，积极推进工艺技术和产品技术的开发与产业化，实现了科技成果与产业的深度融合。

问：公司获得过哪些荣誉？

朱一明：公司在DRAM领域的技术创新实力和知识产权建设方面获得了多项国家级和省级荣誉认可。目前，在国家级荣誉方面，公司分别于2022年和2025年获得第二十三届和第二十五届中国专利优秀奖，并于2022年被认定为国家知识产权优势企业。在省级荣誉方面，公司先后被认定为动态随机存储器安徽省技术创新中心（2020年）、安徽省计算存储器产业创新中心（2020年）、2021年安徽省智能工厂、2023年安徽省科技领军企业、2023年皖美品牌示范企业，并分别于2022年和2024年获得第九届和第十一届安徽省专利金奖。

问：公司营收增长情况如何？

朱一明：2023年至2025年，公司营业收入分别为90.87亿元、241.78亿元和617.99亿元，营业收入复合增长率达到160.78%。2026年1月至3月，公司营业收入为508亿元，较2025年同期增长719.13%。

问：公司的盈利情况如何？

黄丹阳：2023年至2025年，公司净利润分别为-192.25亿元、-90.51亿元和71.44亿元；归母净利润分别为-163.40亿元、-71.45亿元和18.75亿元；扣非归母净利润分别为-167.52亿元、-78.70亿元和53.16亿元。2026年一季度，公司实现净利润330.12亿元，归母净利润247.62亿元，扣非归母净利润263.41亿元，继续保持盈利增长态势。

问：2026年一季度公司业绩大幅增长的驱动因素是什么？

黄丹阳：2026年一季度公司业绩大幅增长，主要是在全球算力需求持续增长、全球主要厂商产能调配等因素影响下，全球DRAM产品供不应求，价格自2025年下半年以来持续呈现大幅上涨趋势所致。同时，随着公司产销规模持续增长，产品结构持续优化，公司营业收入、净利润等均同比大幅增长。

问：公司的综合毛利与毛利率整体变化情况如何？

黄丹阳：2023年至2025年，公司综合毛利率分别为-1.75%、13.49%和253.34%，综合毛利率依次为-1.93%、5.58%和40.99%；剔除存货跌价转销影响后的转销前综合毛利率分别为-112.71%、-4.03%和37.81%，整体呈快速上行态势。

问：公司的研发费用是多少？

黄丹阳：2023年至2025年，公司研发费用分别为45.20亿元、46.07亿元和95.93亿元，累计研发投入达到206.05亿元，占累计营业收入的21.67%。

发展篇

问：公司本次上市后有哪些发展目标？

朱一明：公司通过本次上市：一是增强公司研发创新能力，加快技术迭代和产品布局的完善；二是加快产能建设和升级，增强公司的市场竞争力和盈利能力；三是把握广阔的市场成长空间，加快市场拓展并推动产业发展；四是完善公司治理并持续提升核心竞争力，持续为股东创造长期价值。

问：公司的竞争优势体现在哪些方面？

朱一明：公司在DRAM领域积累了一定的竞争优势。1）研发方面，公司始终坚持自主研发道路，并通过跳代研发加速技术创新，目前，公司的核心产品及工艺技术已达到国际先进水平；2）产能方面，随着公司规划产能建设投入逐步完成及产能快速爬坡，业务规模效应逐步显现；3）产品方面，公司紧跟行业领先技术和下游应用市场发展趋势，通过不断加强研发投入和不懈的技术攻关，产品速率、功耗等性能达到国际先进水平；4）经营管理方面，公司构建了高效的研发创新机制，确保技术研发与产品量产的高效衔接，有效提升了技术的产业化效率；5）产业生态方面，公司与上游EDA厂商、材料厂商、设备及零部件厂商等供应商建立了稳固的合作关系，并通过深化产业链合作，推进供应链的多元化、本土化，增强供应链的安全保障能力；6）管理团队方面，公司管理层的核心领导者拥有25年以上半导体行业经验，截至2025年末，公司研发人员占比超过30%，强大的人才与团队储备是公司保持长久竞争力的重要基础。

问：公司是否有计划在国际市场进行布局？

朱一明：在业务布局上，公司坚持立足国内市场，并逐步拓展海外市场。公司将借助本次发行上市提升自身品牌影响力，进一步拓展全球市场份额，增强对全球下游市场需求的供给保障能力。随着本次上市募集资金建设项目的稳步推进，公司将加速工艺升级，从而实现更低的单位成本，更强的市场竞争力及盈利能力，更有效地满足未来全球下游市场旺盛的需求，助力公司在全球DRAM市场中占据更有利的地位。

问：公司目前在研重点项目有哪些？

朱一明：公司目前重点推进的研发项目主要包括：第四代工艺技术平台及相关产品，基于第四代技术平台，开发容量更大、性能更高的LPDDR4X产品、DDR5产品和LPDDR5X产品，以满足服务器、手机、个人电脑等市场需求；第五代工艺技术平台，采用进一步优化的高曝光技术，进一步提升存储密度和阵列性能，目前处于研发阶段；预研项目及其他，建立未来的DRAM技术平台并开发面向未来市场应用的相关产品及技术，能够基于技术平台设计满足行业JEDEC标准的更高密度LPDDR5X、LPDDR6、DDR5等产品，实现更高密度、更高容量、更高速、更低功耗，满足服务器、移动设备和个人电脑等市场内存需求，目前处于研发阶段。

行业篇

问：服务器DRAM市场的增长前景如何？

朱一明：服务器DRAM有望成为DRAM各应用领域中增长最快的市场之一。根据Omdia数据，2025年，全球服务器DRAM市场占比约为50%，到2030年，服务器DRAM市场占比预计将增长至约71%。数据中心扩张、云计算发展对于数据处理基础设施建设的需求持续快速增长，成为服务器DRAM市场规模扩大的核心驱动力之一。全球服务器搭载的DRAM总量预计将由2025年的约19953MGB增长至2030年的约69340MGB，年复合增长率约为28.29%。

问：移动设备DRAM市场的需求增长主要由哪些因素支撑？

朱一明：移动设备DRAM是DRAM核心下游应用市场之一，其中智能手机应用在移动设备DRAM市场中占有主要份额，其余细分应用包括平板电脑等。移动设备性能提升及功能升级驱动单机内存容量增长，为移动设备DRAM需求提供有力支撑，推动其市场规模稳健增长。根据Omdia预测，全球移动设备搭载的DRAM总量预计将由2025年的约11111MGB增长至2030年的约13776MGB，年复合增长率约为4.39%。

问：个人电脑DRAM市场未来几年的增长预期如何？

朱一明：个人电脑DRAM是DRAM第三大应用市场，主要应用包括台式机和笔记本电脑等。个人电脑的换机升级以及端侧场景的持续拓展，成为驱动个人电脑DRAM市场增长的重要因素。根据Omdia预测，全球个人电脑搭载的DRAM总量预计将由2025年的约5137MGB增长至2030年的

约7930MGB，年复合增长率约为9.07%。

问：自动驾驶和智能座舱的需求将对DRAM产生怎样的影响？

朱一明：智能汽车DRAM正在成为DRAM市场最具潜力的新兴赛道之一。尽管当前智能汽车DRAM占总体市场的比例相对有限，但随着汽车智能化、网联化进程加速，自动驾驶和智能座舱的升级需求有望共同驱动汽车DRAM市场进入高速增长阶段。根据Omdia预测，全球智能汽车搭载的DRAM总量预计将由2025年的约968MGB增长至2030年的约1916MGB，年复合增长率约为14.63%。

问：全球DRAM行业的市场竞争格局如何？

朱一明：DRAM行业自20世纪80年代发展初期的数十家企业，发展到目前全球主要生产厂商包括三星电子、SK海力士、美光科技及长鑫科技等。根据Omdia的数据，基于销售测算，2025年，三星电子、SK海力士和美光科技的市场占有率合计占全球DRAM市场90%以上。近年来，国产DRAM厂商里，公司正逐步进入主要厂商阵营。基于Omdia数据测算，按2025年第四季度DRAM销售额统计，公司的全球市场份额已增至7.67%，并有望随着技术发展及产能建设实现进一步增长。

发行篇

问：公司上市后如何保证无实控人架构的稳定性？

袁园：一方面，公司上市后股权结构将进一步分散，前五大股东持股比例均不超过30%，公司不存在单一持股比例超过50%的股东；另一方面，公司已建立由股东会、董事会、各专门委员会和经营管理层组成的现代企业治理结构。公司董事会由11名成员构成，除4名独立董事外，7名非独立董事实际提名方为：清辉长鑫1席，长鑫集成1席，大基金二期2席，合肥集鑫1席，安徽省投1席，职工董事1席，因此，无任何一名股东通过实际支配表决权能够决定公司董事会半数以上成员的选任。公司上市后预计仍将保持较为分散的董事会提名结构，仍将保持无实际控制人的控制权架构。

问：公司本次发行股数是多少？

吴迪：公司本次拟初始公开发行股票668808.8608万股，占公司发行后总股本的比例约为10.00%（超额配售选择权行使前），全部为公开发行新股，不设老股转让。

问：公司本次发行是否安排超额配售？

魏先勇：公司本次发行安排了不超过初始发行股份数量15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至769130.1608万股，占公司发行后总股本的比例约为11.33%（超额配售选择权全额行使后）。

问：请介绍公司本次发行的战略配售情况。

袁园：公司本次发行的初始战略配售数量为334404.4304万股，占本次发行数量的50.00%，约占超额配售选择权全额行使后发行总股数的43.48%。其中，两家保荐机构合计跟投的初始战略配售数量为26752.3546万股，占本次初始发行数量（不含超额配售选择权）的4.00%；发行人的高级管理人员及核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划初始战略配售数量为66880.8860万股，占本次发行数量（不含超额配售选择权）的10.00%，且认购金额不超过159278.08万元；其他参与战略配售的投资者认购金额不超过108.44亿元。

问：公司本次募集资金的使用规划是什么？

袁园：公司本次募集资金的使用将围绕公司主营业务展开，主要用于存储器晶圆制造量产线技术升级改造项目、DRAM存储器技术升级项目、动态随机存取存储器前瞻技术与开发项目，系基于业务发展阶段特点和技术研发创新要求对公司现有业务进行的扩充和延伸，是公司进一步提高技术与研发实力的必然要求，也是公司持续深化工艺技术开发与积累、不断开拓前沿技术、提升核心竞争力的重要举措。

问：公司募投项目的发展前景如何？

廖小龙：随着DDR5和LPDDR5/5X等产品加速渗透下游市场，服务器、移动设备、个人电脑、智能汽车以及其他多元应用场景的持续发展，DRAM市场需求持续增长，公司的募投项目具有良好的发展前景。